

3WMR16专用COB平面光源 3W定向照明光源

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 3WMR16专用COB平面光源 3W定向照明光源 |
| 公司名称 | 深圳市光拓光电有限公司 |
| 价格 | 4.00/片 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区万利业工业区B栋2层 |
| 联系电话 | 86-075561140499 18675527145 |

产品详情

产品型号：gt1212-3w 光通量：255-330lm 色温：2900-3100k/ 3900-4100k/
6000-6500k 显色：>95 工作电源：9-12v / 300ma 保质/年：2年

结合各方面因素，严格的讲，是要淘汰金属基板cob的。光拓光电有限公司 cob 技术已经经历2代，陶瓷基板 cob 是第三代。前两代均是金属基板技术。我们知道cob是将 led chips 直接邦定(bonding)于导热基板上，那么基板的特性直接影响到最终光源的可靠性及光电指标。

金属基板cob 技术的瓶颈源于金属的固有特性，高热膨胀系数、高导电性、低光反射率等。

瓶颈 1：难以克服的热应力

用于基板的金属主要是铝和铜，其热膨胀系数远大于晶粒的衬底，金属基板cob led 工作在冷热循环的过程中，晶粒将承受很大的热应力及应力冲击，有极大机会发生开焊，导致热量无法导出而在局部富集碳化。热应力是金属基 cob 封装的头号敌人。

瓶颈 2：难以提高的光效。

相对而言，铝和铜的光反射率都较低。提高光反射率都主要靠镀银实现。大多做到 60-70lm/w。在不计成本的情况下，大体也只能做到 80lm/w。另一方面，金属基由于镀银的原因，线路的可焊性有很大不确定因素。为避免固晶焊线风险，多数厂家选择大尺寸芯片以减少焊线及固晶数量。led 芯片的出光效率随驱动电流的升高而降低，也是金属基 cob 光效难以提高的一个因素。

瓶颈 3：mcpcb 的导热系数低 由于金属的导电性，mcpcb

的线路与基板之间必须有绝缘层，绝缘层也是隔热层，使得 mcpcb 的导热系数一般在 0.8-2 之间。对于几瓦级 cob，芯片一般都固于镀银的铜线路上，铜铝的高导热优势荡然无存。十瓦级 cob 的热密度极大，芯片固于镀银的铜线路上是非常不可取的，而去除绝缘层将付出较高代价。直接固晶在镀银无线路金属基上可以很好解决导热问题，却增加了焊线的困难，焊线不良一直是 cob 封装。厂家头疼的问题。同时，依然无法回避热膨胀系数悬殊的问题。

更多详尽资讯信息请登录本公司网站：www.stslight.com 联系方式：肖生 13502849819

qq1634996098 王小姐 18672014709 qq1184974703 刘生
18664580796 qq2601698942 周生 13728958205 qq374159442